新征程，从“芯”开始

中科光芯2019校园招聘

**中科宣言**

如果你想：工作的同时继续深造，成为中科院福建物构所的研究生/博士；

如果你想：从理论研究到研究成果产品化、市场化；

福建中科光芯光电科技有限公司——是您的最佳选择。

**公司简介**

**福建中科光芯光电科技有限公司**成立于2011年8月，注册资本6494.5455万元，总投资近2亿元。公司由中央“千人计划”、福建省、中科院“百人计划”、中国工程院“特聘专家”苏辉先生创立，中国科学院福建物质结构研究所、福建省华兴创业投资有限公司联合投资。

公司以光芯全世界为使命，坚持以技术为核心，以人才为支撑的核心理念。在苏辉博士的带领下，逐步建成包括多名海内外博士、硕士在内的顶尖技术团队，并与中科院等单位共同承担国家“863”项目，军工项目等多个国家级、省级重大科研项目。目前公司产品包括FP、DFB、PIN、APD、SLED芯片和器件等已经实现量产，产品性能得到业内多家大中型组件及模块制造商的肯定。公司获得了国务院“重点华侨华人创业团队”，高新技术产业企业的证书等荣誉。

**苏辉博士：**

国家“千人计划”人才和中国工程院“特聘专家”、中科院“百人计划”和福建省“百人计划”人才、获得求学于武汉大学（本科）、中科院（博士）、美国新墨西哥大学（博士），美国伊利诺依州香槟分校博士后站研究期间还担任ZIA LASER，Research Scientist，Emcore公司Staff Scientist，2010年回国后担任中国科学院研究员、博士生导师，中科光芯创始人。

**拥有的专利：**企业申报及获批的专利有12项，其中包含发明专利5项，实用新型专利7项，平均每年新增30项。

**专项课题介绍：**

国家级项目：与中国科学院等机构联合承担国家863项目，主要针对未来400G通信系统的芯片及器件。公司未来的产品及技术储备。

特发信息：专项开发5G基站用25G光芯片及器件专项；

科大国盾：委托开发量子通讯用光芯片专项课题；

中兴通讯：委托开发硅光用光芯片专项课题；

其他课题：包括可落地的产业化项目。获得其他科研经费达到1600万元。并皆以实物交付，实现产品化。

**芯片产业化：**

建成并投用了国内唯有的两条集MOCVD外延生长、芯片工艺加工线以及TO封装工艺线。

**二、招聘岗位**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 需求岗位 | 需求人数 | 学历要求 | 专业要求 | 其他要求 |
| 芯片研发工程师 | 10 | 博士硕士 | 半导体器件、光学、物理、材料、微电子等专业 | 熟悉半导体激光器工作原理或半导体光学膜系的作用和设计；有InP、GaAs、GaN基半导体器件或激光方向的研究经历的优先考虑。 |
| 外延工艺工程师 | 5 | 本科及以上 | 物理、光电子、半导体材料等专业 | 熟悉外延片生长工艺，有薄膜沉积或半导体光电子材料和器件研究经历的优先考虑。 |
| 芯片/封装工艺工程师 | 5 | 本科及以上 | 光学、物理、机械、微电子等专业 | 熟悉芯片/封装工艺知识，有光刻、镀膜、划裂或封装等相关项目经历。 |
| 机械设计工程师 | 5 | 本科及以上 | 机械类相关专业 | 熟悉机械制图、机械制造技术基础等专业知识，熟悉3D\2D机械设计软件。 |
| 设备工程师 | 5 | 本科及以上 | 机械、电气、自动化等专业 | 熟悉机械图、电气原理图、电路图，有C语言或PLC编程基础。 |

**三、薪酬福利**

公司建立了完善的薪酬福利体系，通过富有竞争力的薪酬体系吸引和留住优秀人才，每年定期根据员工的能力水平和工作表现，对薪酬进行相应调整，保持员工薪酬福利的市场竞争力。

员工保险：除了法定的五险一金外，还为员工购买商业保险；

食宿福利：免费提供食宿（贴心配置空调、热水器等设备）；

员工活动：不定举行公司员工聚会、员工旅游、员工素质拓展等活动；

员工之家：提供400平米员工活动室，配备健身器材、乒乓球室、台球室等；

其他福利：免费班车、专业培训、年终奖金、节日礼金/礼品、生日礼物等。

**四、应聘流程**

简历投递--笔试--面试--Offer--签订三方协议

**五、简历投递方式**

**网络投递：**请将**简历**（**含电子版成绩单**）发送至招聘专用邮箱“hr@litecore.cn”，邮件主题为“姓名+学历+学校+应聘职位”，并在邮件中说明可以到公司实习的时间。

**现场投递：**在宣讲会或招聘会现场投递者请在**简历**（**含成绩单复印件**）右上角标明“姓名+应聘职位+可以到公司实习的时间”。

**六、联系方式**

联系人：叶女士 13559132556

邮箱：hr@litecore.cn

网址：www.litecore.com.cn

地址：福建省福州市鼓楼区软件园E区14号楼 企业公众号

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **岗位名称** | 中级研发工程师 | **直属上级** | 总工程师 |
| **岗位层次** | P6 | **薪资范围** | 年薪15-25W |
| 1. **岗位关系：**

内部联络单位：产线各部门、职能岗位各部门外部联络机构：无 |
| **二、管理范围及幅度：**直接下属岗位名称： 初级研发工程师 间接下属岗位名称：无 |
| **三、工作概述：** 根据总工程师要求开展项目研究活动，编制整合研究资料，对项目产品进一步优化，完成新项目研发计划。 |
| **四、主要工作职责及相关权限：** |
| **岗位职责** |
| **1** | 独立进行量产产品或研发项目的工艺及试验，并进行优化设计和进一步开发； |
| **2** | 编制和整合项目开发过程中形成的各类资料数据，形成完整的项目档案开发资料； |
| **3** | 对于项目开发过程中出现的异常给出建议和意见，并与项目负责人或上级讨论确定下一步方案； |
| **4** | 掌握MOCVD编程规范，检查程序运行中各种流量及阀门，对异常状态做进一步分析并给出调整意见； |
| **5** | 对外延芯片生长质量进行优化设计和进一步开发； |
| **6** | 完成上级要求的其他工作任务； |
| **五、任职资格：** |
| **年龄** | 不限 | **性别** | 不限 |
| **学历专业** | 物理、光电相关专业本科以上学历，硕士/博士学历优先 | **工作经验（经历）** | 具备2-3年的光芯片完整量产或研发项目的开发经验； |
| **英语能力要求** | 1.基本英语口语能力；2.英文资料查询和阅读能力； |
| **经验知识** | 1. 熟悉半导体激光器模式工作原理；
2. 熟悉半导体光学膜系的作用和设计；
3. 熟悉芯片结构与激光光学模式的基本原理；
4. 熟悉激光器内部光电的动态和静态过程；
5. 熟悉激光器在应用端的大、小信号调制原理，及异常形成原因；
6. 熟悉Ⅲ/Ⅴ族半导体材料的MOCVD生长；
7. 熟悉使用matlab、matchcad等进行常规的数学和计算模拟，熟悉使用Rsoft、zmax等进行常规光波导光场模拟，熟悉使用labview、igor或VB等进行基本的仪器控制命令编写。
 |
| **综合能力** | 1. 具备项目开发过程中异常问题点的发现和解决能力；
2. 相关开发项目国内外资料查询、分析和整合对比的能力；
3. 产品质量体系总体报告资料编写能力；
4. 产品开发前后各类资料报告的整合和编写能力。
 |
| **工艺技术能力** | 1. 光刻、镀膜、腐蚀等工艺的异常分析和优化能力；
2. 封装固晶、打线、封帽等工艺的异常分析和优化能力；
3. 芯片和器件测试的异常分析和优化能力，基本测试程序编写能力；
4. 外延材料及其芯片结构的分析能力。
 |
| **六、本岗位职业通道**1、可以轮换岗位：无2、可以晋升岗位：高级研发工程师 |